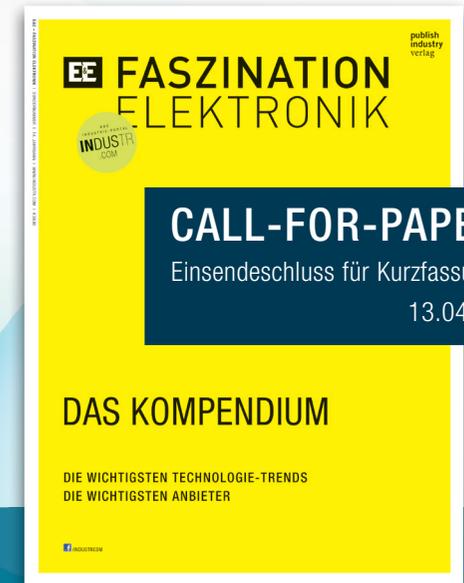


# WIR LADEN SIE EIN: GESTALTEN SIE DAS E&E KOMPENDIUM 2019 MIT

Als Autor eines Fachbeitrags verdeutlichen Sie die Kompetenz Ihres Unternehmens und vermitteln der Fachwelt innovative Produktlösungen und zukunftssträchtige Konzepte aus Elektronik & Entwicklung. Das E&E-Kompodium bildet einmal jährlich die **wichtigsten Technologie-Trends der Elektronikbranche und deren Anbieter** ab. Es erscheint 2018 bereits im 15. Jahrgang.



## WICHTIGE TERMINE

### Beiträge

Rücksendung der Schnellantwort: ab sofort  
Einsendeschluss für Kurzfassungen: 13.04.18

Information über Beitragsauswahl: 27.04.18  
Einsendeschluss für Manuskripte: 22.06.18

### Anzeigen

Anzeigenschluss: 27.08.18  
Druckunterlagenschluss: 03.09.18

### Erscheinungstermin

E&E-Kompodium: 30.10.18

## EINLADUNG

**Verbreitete Auflage Gesamt:** 18.400 Exemplare (7.900 Print, 10.500 E-Paper)

**Redaktionelles Konzept:** Das umfassende Referenzbuch garantiert mit seiner redaktionellen Nachhaltigkeit und Tiefe auf rund 170 Seiten höchsten Lesernutzen. Technische und organisatorische Themen mit aktuell hoher Relevanz liefern detaillierte Hintergrundinformationen zu Entwicklungen und Trends und zeigen Lösungswege für typische Design- & Entwicklungsaufgaben. Das E&E-Kompodium ist auch digital verfügbar unter [INDUSTR.com/EuE](http://INDUSTR.com/EuE).

**Leserzielgruppe:** verantwortliche Fachkräfte und Ingenieure im Entwicklungsprozess moderner Elektronikprodukte, Führungskräfte und Entscheider in der Elektronikbranche

### SO WERDEN SIE AUTOR IM E&E KOMPENDIUM:

- Interessierte Autoren können sich umgehend per E-Mail vormerken lassen
- Für jeden Beitragsvorschlag benötigt die E&E-Redaktion ein Abstract des beabsichtigten Beitrags. Nutzen Sie dazu das offizielle Kurzfassungsformular – es liegt zum Download unter [www.publish-industry.net/media/EuE/Call-for-Papers.doc](http://www.publish-industry.net/media/EuE/Call-for-Papers.doc) bereit.

Ausgefüllte Formulare schicken Sie bitte per E-Mail an [f.streifinger@publish-industry.net](mailto:f.streifinger@publish-industry.net), Einsendeschluss: **23.03.2018**

- Die **Kurzfassung** muss folgende Angaben enthalten:

**Zuordnung zum Themenfeld** (siehe Rückseite), **Name und Anschrift des Autors** (inkl. Telefon/Fax/E-Mail), **Titel des Beitrags** und **Angaben zum Inhalt:**

1. Problemstellung bzw. technische Aufgabenstellung
2. Stand der Technik und bisherige Lösungen
3. Beschreibung des neuen Lösungsansatzes
4. Zielgruppe des Beitrags

- Die **Bewertung der Kurzfassungen und die Entscheidung** über die Annahme bzw. Ablehnung der Beiträge erfolgt durch die Redaktion und den redaktionellen Beirat des E&E-Kompodiums. Als Richtlinie für die Länge des späteren ausführlichen Beitrags sind rund 8000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Manuskriptgestaltung erhalten Sie mit der Information über die Beitragsannahme. Bitte beachten Sie, dass ein zur Veröffentlichung im E&E-Kompodium vorgesehener Beitrag den Charakter eines Fachaufsatzes haben muss. Von der Einsendung werblicher Texte bitten wir abzusehen.

# DIE THEMENFELDER

## **FOKUSTHEMA: PREDICTIVE MAINTENANCE**

Bauteile, Komponenten und Software für die vorausschauende Instandhaltung.

## **STROMVERSORGUNG & LEISTUNGSELEKTRONIK**

Netzteile  
Wandler  
Akkumulatoren  
Batterien  
Ladetechnik  
IGBTs  
MOSFETs  
Thyristoren  
Smart-Power-ICs  
Diskrete Bauteile  
Power-Management

## **PASSIVE BAUELEMENTE & ELEKTROMECHANIK**

Kondensatoren  
Widerstände  
Induktivitäten  
Quarze  
Oszillatoren  
Transformatoren  
Drosseln  
Spulen  
Filter  
Ferrite  
Keramika  
Gehäuse  
Kühltechnik  
Backplanes  
Zubehör  
Relais

## **DISTRIBUTION & DIENSTLEISTUNG**

Bauteilebeschaffung  
Technische Beratung  
EMV-Dienstleistungen  
Supply-Chain-Management  
Logistik  
Online-Services  
Obsoleszenzmanagement  
Bauteilenachverfolgbarkeit

## **ENTWICKLUNGSTOOLS & PROTOTYPING**

Chip- & PCB-Design  
EDA-Tools  
CAD/CAE-Werkzeuge  
Entwicklungstools  
EMS  
Prototypenfertigung  
3D-Druck  
Entwicklungskits & -boards  
Simulation  
Messtechnik  
Testsoftware  
Halbleitermaterialien

## **VERBINDUNGSTECHNIK & WIRELESS**

Steckverbinder  
Klemmen  
Anschlusstechnik  
Kabel  
Lichtwellenleiter  
Wireless-Technologien  
Netzwerktechnik  
Messtechnik für Verbindungskomponenten

## **EMBEDDED-SYSTEME & MIKROCONTROLLER**

Embedded-Boards & -Module  
IPCs  
Plattformen  
MCUs  
DSPs  
FPGAs  
SoCs  
Chipsätze  
Prozessorarchitekturen  
Speicher

## **SOFTWARE & SECURITY**

Betriebssysteme  
Embedded-Software  
Lizenzierung  
Software-Engineering  
Hardware- & Software-Security

## **DISPLAYS & HMI**

Displaytechnologien  
Ansteuerelektronik  
Display-Integration  
Touch-Technologien  
Eingabesysteme  
Schalter  
Taster  
Tastaturen

Sie können leider keinen Fachbeitrag für das E&E-Kompodium vorschlagen, haben jedoch Interesse an weiteren Beteiligungsformen?

Melden Sie sich bei Saskia Albert:  
[s.albert@publish-industry.net](mailto:s.albert@publish-industry.net)